

111 學年度「微電子製程跨領域學分學程」總表

| 開課系所 | 課程名稱       | 學分/時數 | 開課學期 | 備註         |
|------|------------|-------|------|------------|
| 電子系  | 電路佈局實務     | 2/3   | 一上   |            |
| 電子系  | 線性代數       | 3/3   | 一上   |            |
| 材料系  | 材料製程概論     | 3/3   | 一下   |            |
| 電子系  | 半導體工程      | 3/3   | 二上   |            |
| 電子系  | 半導體材料檢測    | 3/3   | 二上   |            |
| 電機系  | IC 設計及製程概論 | 3/3   | 二上   |            |
| 材料系  | 光電材料製程實務   | 3/3   | 二上   |            |
| 材料系  | 真空技術與實務    | 3/3   | 二上   |            |
| 電子系  | 光電子學       | 3/3   | 二下   |            |
| 電子系  | 高速電路       | 3/3   | 二下   |            |
| 材料系  | 電子材料       | 3/3   | 二下   |            |
| 電子系  | 電磁學        | 3/3   | 二下   |            |
| 材料系  | 能源材料製程實務   | 3/3   | 二下   |            |
| 電子系  | RF 電路設計    | 3/3   | 三上   |            |
| 電子系  | 半導體元件      | 3/3   | 三上   |            |
| 電子系  | 固態照明元件     | 3/3   | 三上   |            |
| 電子系  | 類比積體電路佈局   | 3/3   | 三上   |            |
| 材料系  | 半導體製程      | 3/3   | 三上   | 最多承認<br>一門 |
| 機械系  |            | 3/3   | 三下   |            |
| 電子系  | 半導體封裝      | 3/3   | 四上   |            |
| 電子系  | 晶片設計實務     | 3/3   | 四上   |            |
| 電子系  | 半導體產業實務講座  | 3/3   | 四上   |            |
| 材料系  | 薄膜製程       | 3/3   | 四上   |            |
| 電子系  | 半導體測試      | 3/3   | 四下   |            |
| 材料系  | 光電半導體材料    | 3/3   | 四下   |            |